

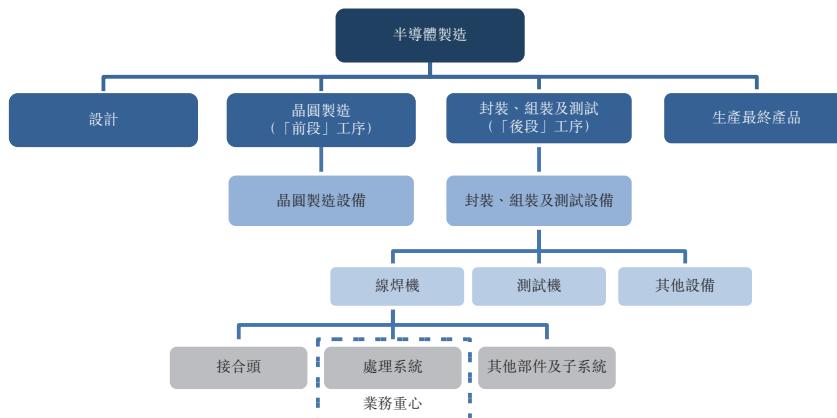
概要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料之概覽。由於僅為概要，故並不包含所有對閣下而言可能屬重要之資料，且應與本文件全文一併閱讀，以確保其完整性。閣下決定投資[編纂]之前，應閱讀整份文件。任何投資均涉及風險。投資[編纂]的部分獨有風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定投資[編纂]前，應先細閱該節。

概覽

我們是1988年在新加坡成立的合約製造商，專門生產半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件。我們的產品主要由(i)半導體加工設備(即用作製造或加工半導體的設備)的原始設計製造商以及(ii)半導體加工設備用家採購。我們的產品一般作為半導體加工設備的部件用於生產半導體或用於生產或加工半導體^(附註)。於營業紀錄期間，我們的大部分收益來自製造線焊處理系統(即半導體後段設備線焊機的重要子系統)。根據行業報告，按收益計，在全球線焊機處理系統合約製造行業中，我們是全球最大的線焊機處理系統合約製造商，2017年的市場份額約為49.6%。

有關我們市場的其他資料，請參閱本文件「行業概覽」一節。下圖概述半導體製造工序及相關半導體加工設備細分：

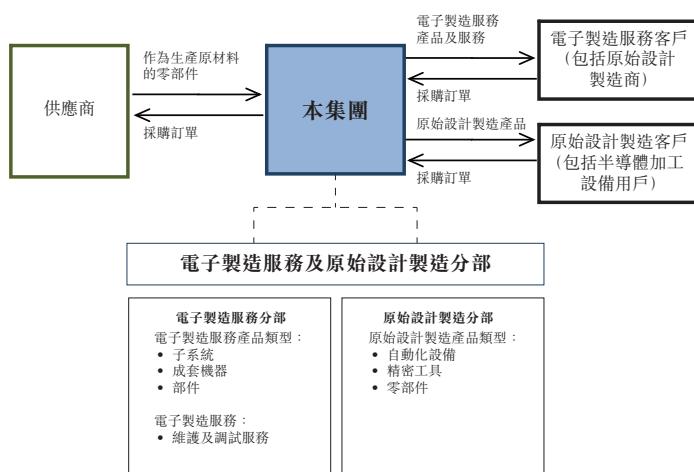


附註：半導體的最終產品裝置為智能手機、消費電子及電腦等數碼產品。

概要

業務模式

以下簡圖說明我們現時的業務模式：



營業紀錄期間，我們有電子製造服務分部(「電子製造服務分部」)及原始設計製造分部(「原始設計製造分部」)兩個分部。電子製造服務分部主要製造子系統、成套機器及部件，以及提供保修期後維護及調試服務。原始設計製造分部主要設計及製造自動化設備、精密工具及部件。

下表載列營業紀錄期間按分部及產品種類與服務劃分的分部收益：

截至12月31日止年度								
2015年			2016年			2017年		
佔電子製造服務分部/原始設計製造分部收益的百分比	佔本集團收益的百分比	千新加坡元	佔電子製造服務分部/原始設計製造分部收益的百分比	佔本集團收益的百分比	千新加坡元	佔電子製造服務分部/原始設計製造分部收益的百分比	佔本集團收益的百分比	千新加坡元
電子製造服務分部								
產品								
子系統	58,518	62.8	54.7	90,053	92.0	84.2	114,401	95.7
成套機器	22,907	24.6	21.4	2,597	2.7	2.4	255	0.2
部件	1,619	1.7	1.5	2,075	2.1	1.9	4,459	3.7
服務								
維護及調試服務	10,191	10.9	9.6	3,155	3.2	3.0	412	0.4
小計	93,235	100.0	87.2	97,880	100.0	91.5	119,527	100.0
原始設計製造分部								
產品								
自動化設備	4,702	34.4	4.4	2,432	26.7	2.3	3,342	35.5
精密工具	4,644	34.0	4.3	2,842	31.2	2.6	2,430	25.8
零部件	4,315	31.6	4.1	3,843	42.1	3.6	3,653	38.7
小計	13,661	100.0	12.8	9,117	100.0	8.5	9,425	100.0
總計	106,896	100.0	100.0	106,997	100.0	100.0	128,952	100.0

概 要

下表列出營業紀錄期間按客戶所在地區劃分的收益：

	截至12月31日止年度					
	2015年		2016年		2017年	
	千新加坡元	%	千新加坡元	%	千新加坡元	%
新加坡 ⁽¹⁾	61,244	57.3	86,390	80.7	114,492	88.8
菲律賓	4,623	4.3	2,590	2.4	3,550	2.7
美國 ⁽²⁾	30,264	28.3	9,779	9.2	3,358	2.6
中國	4,460	4.2	4,101	3.8	1,662	1.3
日本	1,255	1.2	582	0.5	2,781	2.2
其他 ⁽³⁾	5,050	4.7	3,555	3.4	3,109	2.4
總計	<u>106,896</u>	<u>100.0</u>	<u>106,997</u>	<u>100.0</u>	<u>128,952</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 營業紀錄期間，新加坡市場的收益增加主要是由於客戶甲在中國市場擴展業務，令其子系統需求訂單增加。
2. 營業紀錄期間，美國市場的收益減少主要是由於整機需求減少，加上2016年一個項目完成導致來自美國客戶的服務收入減少。
3. 包括馬來西亞、台灣、越南、泰國、斯里蘭卡、印尼、墨西哥、瑞士及荷蘭。

以上數字列出營業紀錄期間按客戶所在地劃分的收益。由於我們的客戶為跨國企業，有可能由並非位於中國的區域辦事處發出訂單，因此以上明細數字未必直接反映我們能夠掌握中國半導體加工設備行業發展向好的機會。按本文件「業務 — 業務戰略」一節所述，董事預料本集團可以借助上述行業發展的優勢。然而，行業顧問確認，營業紀錄期間我們的十大客戶(半導體加工設備製造商)的主要市場在中國。因此，透過向中國市場營運的客戶銷售，我們的產品實際在中國出售。特別指出，營業紀錄期間我們兩名主要客戶(即客戶甲及客戶丁)主要市場在中國，截至2017年12月31日止三年度合計佔我們總收益分別約52.8%、79.4%及84.1%。因此，董事認為我們可從半導體加工設備製造商遷往中國以及中國半導體加工設備行業的預期增長中受惠。

客戶

電子製造服務分部的客戶包括生產半導體加工設備的原始設計製造商，而原始設計製造分部的客戶包括半導體加工設備用戶。我們的客戶亦來自其他行業，包括數據儲存、SMT與測試及計量行業。截至2017年12月31日止三年度，自五大客戶所得總收益分別約

概 要

93.2百萬新加坡元、95.8百萬新加坡元及119.7百萬新加坡元，佔本集團同期總收益約87.2%、89.5%及92.9%。我們於營業紀錄期間的五大客戶均為獨立第三方。

營業紀錄期間，我們的主要客戶為客戶甲，截至2017年12月31日止三年度，該客戶分別貢獻我們總收益約48.5%、72.6%及77.9%。客戶甲自1999年起與我們合作，根據行業報告，按2017年銷售收益計該客戶是全球領先線焊設備製造商之一。我們未取得客戶甲同意在本文件披露其身份。

詳情請參閱本文件「業務 — 客戶」一節。

定價政策

我們的定價政策乃基於成本加定價模式。我們釐定產品價格時會計及客戶忠誠度、與客戶的業務關係及採購和生產成本等各種因素。詳情請參閱本文件「業務 — 定價政策」一節。

信貸政策

我們通常向客戶授出自發票日期起計30至90日的信貸期。信貸期長短視乎具體情況而有所不同，其中包括客戶的聲譽及信譽、還款紀錄及與我們的業務關係。詳情請參閱本文件「業務 — 信貸政策」一節。

銷售及市場推廣

我們的客戶服務團隊負責本集團的銷售及市場推廣。為提升品牌知名度及尋找潛在客戶，我們出席全球各地的行業展會並在貿易期刊刊登廣告。詳情請參閱本文件「業務 — 銷售及市場推廣」一節。

保密

2016年，我們就其中一名客戶乙的新一代產品信息遭洩露而向其賠償約6.9百萬新加坡元。我們採取若干措施以為客戶保密。詳情請參閱本文件「業務 — 知識產權 — 保密」一節。

概 要

供應商

我們除自身製造生產所需部件外，亦向第三方供應商採購。我們就生產產品所採購的主要原材料包括商用成品(如動力控制部件、感應器、電子部件及五金器具)及根據客戶具體要求製作的加工品(如金屬機械部件及框架)。營業紀錄期間，我們自中國、新加坡及馬來西亞採購原材料。截至2017年12月31日止三年度，自五大供應商的總採購額分別約12.9百萬新加坡元、18.2百萬新加坡元及26.4百萬新加坡元，佔我們同期總採購額約19.3%、25.2%及26.8%。於營業紀錄期間，我們的五大客戶均為獨立第三方。

詳情請參閱本文件「業務 — 原材料及供應商」一節。

競爭優勢

我們認為我們的成功及未來增長歸因於以下競爭優勢：(i)我們為歷史悠久的合約製造商，在半導體後段設備行業有逾30年營運紀錄，充分受惠於利好的行業增長；(ii)我們紮根新加坡，在中國戰略投放完善生產設施，由有新加坡背景的高級管理層管理；(iii)我們堅守品質，獲世界領先企業客戶認可；(iv)我們具備強大的精密工程製造能力，為客戶增加價值；(v)我們具備強大的研發能力，參與客戶的產品開發；及(vi)我們具備高素質、表現優異且經驗豐富的管理及技術團隊。

詳情請參閱本文件「業務 — 競爭優勢」一節。

業務戰略

為把握有利行業發展的機會及擴大客戶基礎，我們有以下策略：(i)致力擴大產能；(ii)擴大日本、歐洲及美國的市場份額；(iii)透過併購及內部開發和獲取主要用於發展半導體前段設備行業的工程及技術知識；及(iv)加強研發以把握並貼緊技術動態發展。

詳情請參閱本文件「業務 — 業務戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」各節。

概 要

競爭格局

我們的客戶雖來自不同行業，但我們的收益主要來自線焊機處理系統銷售。根據行業報告，就合約製造線焊機所用處理系統市場而言，我們於2017年佔據主導地位，所得收益約為74.3百萬美元，佔市場總規模約49.6%。全球線焊機處理系統合約製造行業的五大參與者合共佔市場總規模約78.4%。全球線焊機處理系統合約製造有望保持增長態勢。預期2017年至2022年的市場規模將以約7.2%的複合年增長率增長，至2022年達到約211.5百萬美元。

風險因素

下文載列對我們有重大不利影響的部分重大風險：

- 營業紀錄期間我們依賴單一最大客戶客戶甲；
- 我們通常不會與客戶訂立長期協議；
- 我們未必能應對半導體行業的技術變化；
- 營業紀錄期間一名客戶因我們洩露機密資料提出索償，且第三方可能會對我們提出其他知識產權索償，若判決結果對我們不利，我們可能須支付高額賠償。

本公司於新加坡註冊成立，而新加坡的稅法可能有別於香港等其他司法權區。有意投資者應就購買、擁有或出售股份的整體稅務後果諮詢稅務顧問。有關新加坡稅法的詳情，請參閱本文件「監管概覽」一節。

法律訴訟及合規

於營業紀錄期間及截至最後可行日期，我們並無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索賠。詳情請參閱本文件「業務 — 法律訴訟及合規」一節。於營業紀錄期間及截至最後可行日期，除本文件「業務 — 法律訴訟及合規 — 監管合規」一節所載不合規事件外，本集團並無嚴重違反相關法律及法規。

概 要

股東資料

緊隨[編纂]完成後(不計及可能因行使[編纂]及可能根據購股權計劃授出的購股權而配發及發行的任何股份)，本公司將由(i)林氏家族(包括林先生、符女士及林欽銘先生，作為一組控股股東)擁有約33.67%；及(ii)中國光大關聯方(包括鑽裕及其控股公司、杜先生及Sino Expo，作為另一組控股股東)擁有約32.19%。有關詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。

[編纂]投資

我們的[編纂]投資者鑽裕為光大控股的附屬公司。光大控股為中國光大集團的附屬公司。[編纂]投資分兩期，分別於2016年10月19日及2017年12月21日完成。[編纂]投資完成後，鑽裕持有本公司已發行股本約42.93%，而鑽裕同期由CE Venture及杜先生分別持有97%及3%權益。根據於2018年2月5日進行的股份互換，鑽裕向杜先生全資擁有的投資公司Sino Expo轉讓本公司已發行股本約1.29%，代價為杜先生向CE Venture轉讓3%鑽裕已發行股本。因此，鑽裕及Sino Expo分別持有本公司發行股本約41.64%及1.29%。詳情請參閱本文件「歷史及發展 — [編纂]投資」一節。

財務資料及經營數據概要

下表概述營業紀錄期間綜合損益表及其他財務資料：

綜合全面收入表摘要

	截至12月31日止年度		
	2015年 千新加坡元	2016年 千新加坡元	2017年 千新加坡元
收益 ⁽¹⁾	106,896	106,997	128,952 ⁽²⁾
銷售成本 ⁽³⁾	(81,396)	(85,080)	(104,142)
毛利	25,500	21,917	24,810
年度利潤	11,234	3,096 ⁽⁴⁾	8,032
年度全面收入總額	11,843	1,719 ⁽⁴⁾	7,661

概 要

附註：

1. 營業紀錄期間總收益一直增加。然而，營業紀錄期間來自我們一名主要客戶(客戶乙)的收益嚴重下滑。截至2017年12月31日止三年度，客戶乙貢獻的收益分別約為24.8百萬新加坡元、4.9百萬新加坡元及零，分別佔同期總收益約23.2%、4.6%及零。來自客戶乙的收益減少是由於2016年我們的一名僱員現場參觀客戶乙的生產設施時洩露客戶乙的保密資料，此後我們與客戶乙的服務合約終止。然而，由於該事件發生後我們一直與客戶乙商討日後的合作及業務預期，故董事認為該等事件不會對我們與客戶乙日後的業務關係造成不利影響。有關此次事件詳情，請參閱本文件「業務 — 知識產權 — 保密」一節。
2. 截至2017年12月31日止年度與2016年同期比較，收益增加，主要是由於客戶甲在中國市場擴張業務而有強大需求。
3. 我們的銷售成本主要包括(i)直接材料成本；(ii)勞工成本；及(iii)製造成本。詳情請參閱本文件「財務資料 — 綜合損益表的若干主要項目說明 — 銷售成本」一節。
4. 截至2016年12月31日止年度與2015年同期比較，利潤及全面收入總額均減少，主要是由於給予客戶乙的一次過非經常性賠償約6.9百萬新加坡元所致。有關導致賠償的事件詳情，請參閱本文件「業務 — 知識產權 — 保密」一節。

毛利及毛利率

	截至12月31日止年度					
	2015年		2016年		2017年	
	毛利 千新加坡元	毛利率 (%)	毛利 千新加坡元	毛利率 (%)	毛利 千新加坡元	毛利率 (%)
電子製造服務分部	23,441	25.1 ⁽¹⁾	20,015	20.4	23,097	19.3
原始設計製造分部	2,059	15.1	1,902	20.9	1,713	18.2
總計	<u>25,500</u>	<u>23.9</u>	<u>21,917</u>	<u>20.5</u>	<u>24,810</u>	<u>19.2</u>

附註：

1. 2015年毛利率較高，主要是由於電子製造服務分部的毛利率上升，主要原因在於為一位美國客戶測試我們製造的機械而提供的維修、保養及技術服務佔同期總收入約9.0%，而截至2015年12月31日止年度原始設計製造分部由於有大約0.7百萬新加坡元開發成本減值計入的銷售成本使毛利率下降，抵銷了毛利率部分升幅。一般而言，原始設計製造分部的毛利率隨產品類別而變化，視乎所製造產品的複雜程度和訂單多少與所投入勞工多少而定。

概 要

綜合財務狀況表摘要

	12月31日		
	2015年 千新加坡元	2016年 千新加坡元	2017年 千新加坡元
非流動資產	18,830	18,320	20,414
流動資產	64,346	67,744	78,924
流動負債	22,374	21,487	27,945
流動資產淨值	41,972	46,257	50,979
非流動負債總額	734	770	1,100
資產淨值	60,068	63,807	70,293 ⁽¹⁾

附註：

1. 2016年12月31日與2017年12月31日比較，資產淨值增加，主要是由於我們於接近該年年底獲得的採購訂單增加，導致存貨增加，再加上投資中國多間銀行所發行的銀行金融產品，導致可供出售投資增加。

綜合現金流量表摘要

	截至12月31日止年度		
	2015年 千新加坡元	2016年 千新加坡元	2017年 千新加坡元
經營活動產生的現金流淨額	14,009	1,906	3,017
投資活動(所用)／所得現金流淨額	(12,104)	6,035	(9,772)
融資活動(所用)／所得現金流淨額	(2,610)	1,120	(1,261)
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(705)	9,061	(8,016)
財政年度初現金及現金等價物	13,736	13,248	21,820
匯率變動對現金及現金等價物的影響	217	(489)	(147)
財政年度末現金及現金等價物	13,248	21,820	13,657

概 要

重要財務比率

	於12月31日／截至12月31日止年度		
	2015年	2016年	2017年
流動比率	2.9倍	3.2倍	2.8倍
槓桿比率 ⁽¹⁾	1.6%	0.1%	不適用
負債權益比率	不適用	不適用	不適用
利息覆蓋率	152.8倍	184.1倍	275.0倍
總資產收益率 ⁽²⁾	13.5%	3.6%	8.1%
股本回報率 ⁽³⁾	18.7%	4.9%	11.4%
純利率	10.5%	2.9% ⁽⁴⁾	6.2%
經調整純利率	10.5% ⁽⁵⁾	9.3% ⁽⁶⁾	6.8% ⁽⁷⁾

附註：

1. 槓桿比率按相關年末的計息銀行及其他借款總額除以權益總額再乘以100%計算。
2. 截至2015年12月31日止年度與2016年同期比較，資產收益率大幅減少，主要是由於在2016年結算客戶申索以致2016年利潤減少。總資產收益率其後於截至2017年12月31日止年度增加，主要是由於2017年利潤增加所致。
3. 截至2015年12月31日止年度與2016年同期，股本回報率減少，主要是由於在2016年結算客戶申索以致2016年利潤減少。股本回報率其後於截至2017年12月31日止年度增加，主要是由於該年度利潤增加所致。
4. 2016年利率低主要是由於給予客戶乙的一次過非經常性賠償約6.9百萬新加坡元所致。有關導致賠償的事件詳情，請參閱本文件「業務 — 知識產權 — 保密」一節。
5. 計算經調整純利率時並無就截至2015年12月31日止年度的純利作出調整。
6. 計算截至2016年12月31日止年度的經調整純利率時已剔除已付客戶乙的賠償6.9百萬新加坡元。有關導致該筆賠償的事件詳情，請參閱本文件「業務 — 知識產權 — 保密」一節。
7. 計算截至2017年12月31日止年度的經調整純利率時已自當年純利中剔除上市開支。經調整純利率由截至2016年12月31日止年度約9.3%降至截至2017年12月31日止年度的6.8%，主要是由於截至2017年12月31日止年度錄得外匯虧損淨額2.2百萬新加坡元，而截至2016年12月31日止年度錄得外匯收益0.6百萬新加坡元。

有關重要財務比率的詳情請參閱本文件「財務資料 — 財務比率概要」一節。

概 要

近期發展及無重大不利逆轉

截至最後可行日期，我們有三個正在營運的生產設施位於新加坡、中國及菲律賓，總建築面積約為273,947.1平方米。詳情請參閱本文件「業務 — 生產設施」一節。為把握有利的行業發展機會，我們根據未來計劃翻新於截至最後可行日期並無營運的其中一個生產設施中國南通二號廠房。詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]用途 — [編纂]用途」一節。

自2017年12月31日起，我們的業務模式保持不變，且收益及成本架構保持穩定。我們目前預測截至2018年12月31日止年度的財務業績會受到已經且將會於綜合損益表確認為開支的非經常性[編纂]開支約2.3百萬新加坡元(按假設[編纂]每股[編纂][編纂]即指示[編纂]範圍的中間價計算)的負面影響。就董事所知，我們的業務並無會對我們的財務及經營狀況有重大不利影響的任何潛在中斷。

董事確認，自2017年12月31日至本文件日期，(i)市況或我們所經營的行業及環境並無重大不利變動而會嚴重不利我們的財務或營運狀況；(ii)本集團的經營及財務狀況或前景並無重大不利逆轉；及(iii)並無發生任何情況導致本文件附錄一會計師報告所載資料受到重大不利影響。

從新交所除牌

本公司於2007年2月15日在新交所上市，其後於2013年3月22日從新交所除牌，是由於(其中包括)交投量低且管理更靈活。詳情請參閱本文件「歷史及發展 — 從新交所除牌」一節。

股息

我們並無就日後派付股息設立任何政策。截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年度各年，本集團分別宣派股息約1.3百萬新加坡元、2.6百萬新加坡元及7.7百萬新加坡元。根據[編纂]投資的購股協議，在不違反新加坡法律規定的前提下，一經獲得聯交所批准本公司的[編纂]申請，於完成[編纂]前，林先生及Unitras須促成本公司於2018年7月派付股息約28.4百萬新加坡元，包括(i)向除鑽裕及Sino Expo外的現有股東派付股息約7.7百萬新加坡元；(ii)向除鑽裕及Sino Expo外的現有股東派付股息約4.4百萬新加坡元，即2016年1月1日至2016年9月30日止財政期間的一半經調整純利；及(iii)向全體股東派付股息約16.3百萬新加坡元，即截至2018年4月30日的剩餘未分派利潤。該等股息將以內部現金資源(包括營運

概 要

所得現金淨額)派付，必要時會提取未動用的銀行融資，且會於[編纂]前結清。詳情請參閱「財務資料 — 股息」一節。除上文所披露者外，我們並無計劃在[編纂]前支付或宣派任何股息。為股東整體利益行事，我們會將盈利優先用於業務發展及擴大客戶基礎，因此不擬於[編纂]後確定任何預計派息率。董事日後經考慮我們的營運與盈利、資本要求及盈餘、整體財務狀況、合約限制、資本開支及未來發展需要、股東利益及彼等當時認為相關的其他因素後，或會建議派付股息。

[編纂]統計數據

	按指示[編纂]下限每股 [編纂]計算	按指示[編纂]上限每股 [編纂]計算
	港元	港元
市值 ⁽¹⁾	[編纂]	[編纂]
每股[編纂]經調整綜合有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]

附註：

1. 本表格全部統計數字均假設[編纂]未獲行使。
2. 市值乃根據緊隨[編纂]完成後已發行股份[編纂]股計算，且並無計及任何可能因行使[編纂]而發行的股份。
3. 每股[編纂]經調整綜合有形資產淨值乃根據緊隨[編纂]完成後已發行股份[編纂]股計算，且並無計及任何可能因行使[編纂]而發行的股份。
4. 並無作出調整以反映2017年12月31日後本集團的任何經營業績或公開交易。具體而言，本集團的[編纂]經調整有形資產淨值並無計及[編纂]前將宣派及派付的股息約28.4百萬新加坡元。倘計及上述股息，則根據[編纂]每股股份[編纂]及[編纂]計算，每股[編纂]有形資產淨值分別應為每股[編纂]及[編纂]。

[編纂]用途

經扣除[編纂]及[編纂]的估計開支，並假設[編纂]按指示[編纂]範圍的中間價每股[編纂][編纂]進行且[編纂]未獲行使，我們估計[編纂][編纂]約為[編纂](約等於[編纂])。我們擬

概 要

將[編纂]的全部[編纂]作以下用途：

[編纂]用途	佔[編纂]百分比	百萬港元	(等於百萬新加坡元)
擴充我們的產能	[編纂]	[編纂]	[編纂]
開發及收購工程及技術知識	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大日本、歐洲及美國的營銷活動	[編纂]	[編纂]	[編纂]
加強研發	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]

有關詳情，請參閱本文件「未來計劃及[編纂]用途 — [編纂]用途」一節。

[編纂]開支

有關[編纂]的[編纂]開支主要包括專業費用及[編纂]佣金，估計約為[編纂]百萬新加坡元(假設[編纂]按[編纂]範圍的中間價每股[編纂][編纂]進行)。上述估計的[編纂]開支為非經常性質。[編纂]開支當中(i)約[編纂]百萬元直接來自發行[編纂]，將根據相關會計準則入賬列作股權扣減；及(ii)約[編纂]百萬已經或將會自綜合損益表扣除，當中(a)截至2017年12月31日止年度已確認約[編纂]百萬及(b)約[編纂]百萬預計於[編纂]前或當時入賬。

詳情請參閱本文件「財務資料 — [編纂]開支」一節。

於香港[編纂]的理由

董事經考慮以下理由，認為[編纂]對本集團的業務擴張及長期目標有利，符合本公司及股東的整體利益：(i)香港證券市場的戰略地位與我們於日本、歐洲及美國的擴張計劃一致；(ii)香港是國際金融中心，於香港[編纂]對我們日後投資或收購相當重要；(iii)香港更容易獲得資金及日後集資；及(iv)成功[編纂]可提升我們吸引香港及中國人才的能力。

詳情請參閱「歷史及發展 — 於香港[編纂]的理由」一節。